



株式会社バイ・テクノロジー
2025年3月期(第28期) 決算説明会

決算補足資料

(2024年4月1日～2025年3月31日)

2025年5月14日

目次

- I. FY25/3 決算概要
- II. FY26/3 業績予想
- III. 中期経営計画 振り返りと今後について
- IV. その他 地域・社会貢献活動の取組例

I. 2025年3月期決算概要

1. 連結業績サマリー
2. セグメント別業績
3. 地域別売上高
4. 販売費及び一般管理費
5. 貸借対照表
6. 受注・受注残の状況
7. ご参考資料

1. 連結業績サマリー

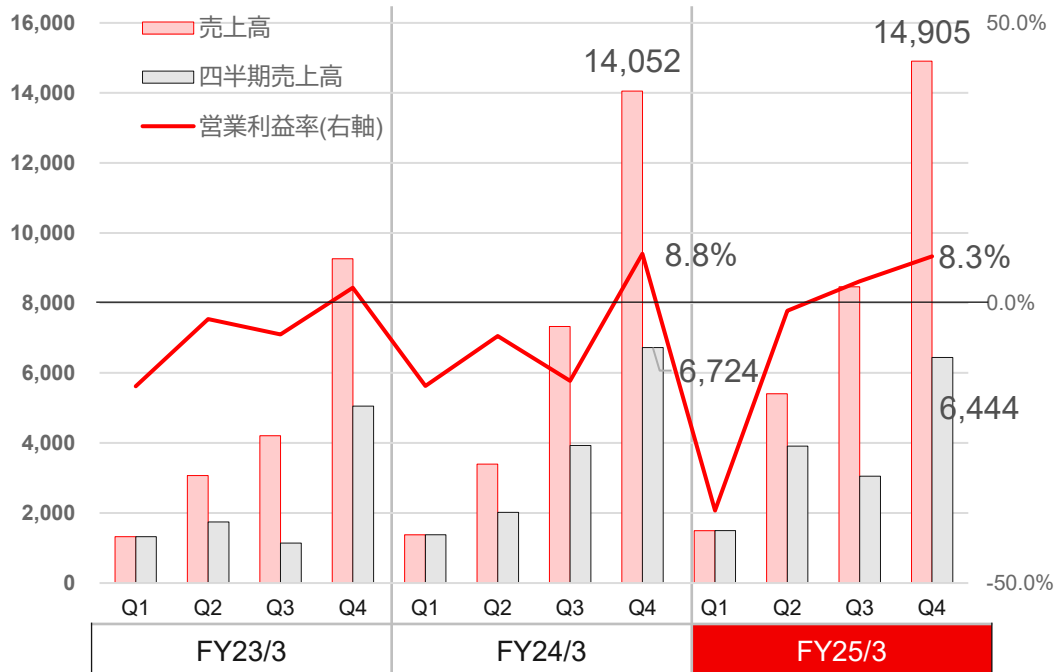
- 前期比 : 増収増益
- 業績予想比
 - ① 売上高 : フォトマスク装置の延伸等により、予想を下回る(▲818百万円)
 - ② 営業利益: 粗利率の改善により、予想を上回る(+221百万円)
 - ③ 経常利益: 営業利益増及び為替差益等により、予想を上回る(+491百万円、+35.1%)
 - ④ 最終利益: 不振事業の固定資産減損(▲560百万円)により、予想を下回る(▲200百万円)

	FY24/3 実績	FY25/3予実			
		予想	実績	前期比	予想比
売上高 (百万円)	37,335	47,000	46,182	+23.7%	▲1.7%
営業利益	846	1,600	1,821	+115.3%	+13.8%
(利益率%)	2.3%	3.4%	3.9%	+1.6%	+0.5%
経常利益	1,112	1,400	1,891	+70.0%	+35.1%
(利益率%)	3.0%	3.0%	4.1%	+1.1%	+1.1%
親会社株主に帰属する当期純利益	778	1,000	800	2.8%	▲20.0%
(利益率%)	2.1%	2.1%	1.7%	▲0.4%	▲0.4%

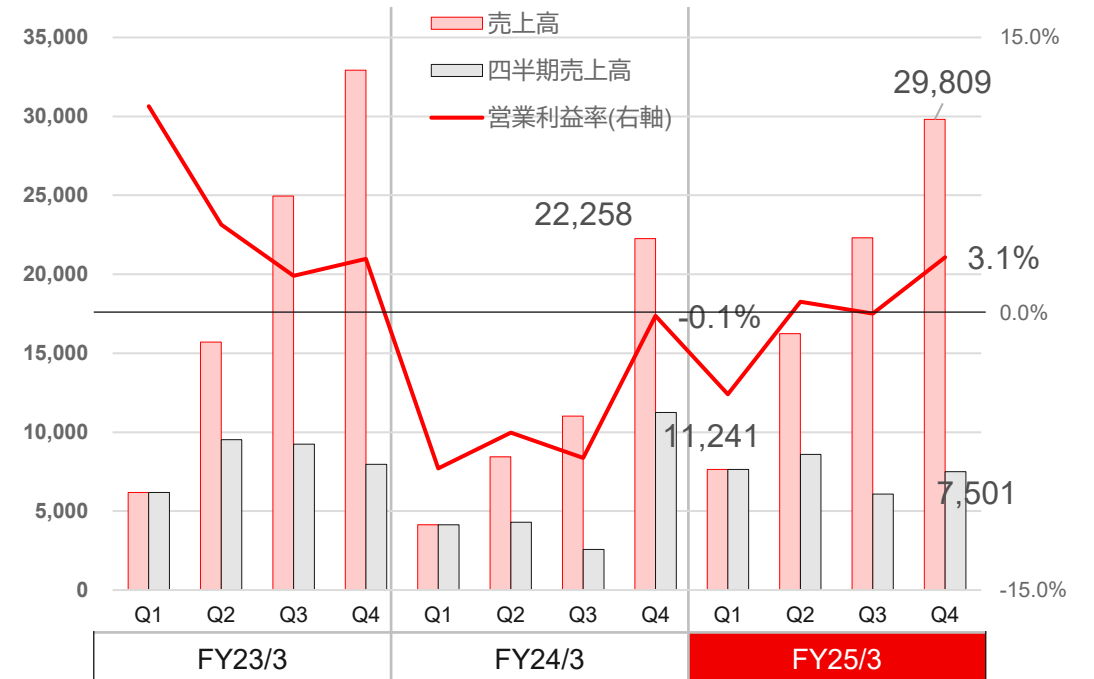
2. セグメント別業績

- 半導体・フォトマスク装置事業 : 売上・利益ともに前期比で微増
- FPD装置事業 : 設備投資が回復し、前期比で大幅増収増益

半導体・フォトマスク装置事業(単位:百万円)			
	FY24/3	FY25/3	前年同期比
売上高	14,052	14,905	+6.1%
営業利益(▲損失) (セグメント利益率)	1,234 (8.8%)	1,242 (8.3%)	+0.7% (▲0.5%)



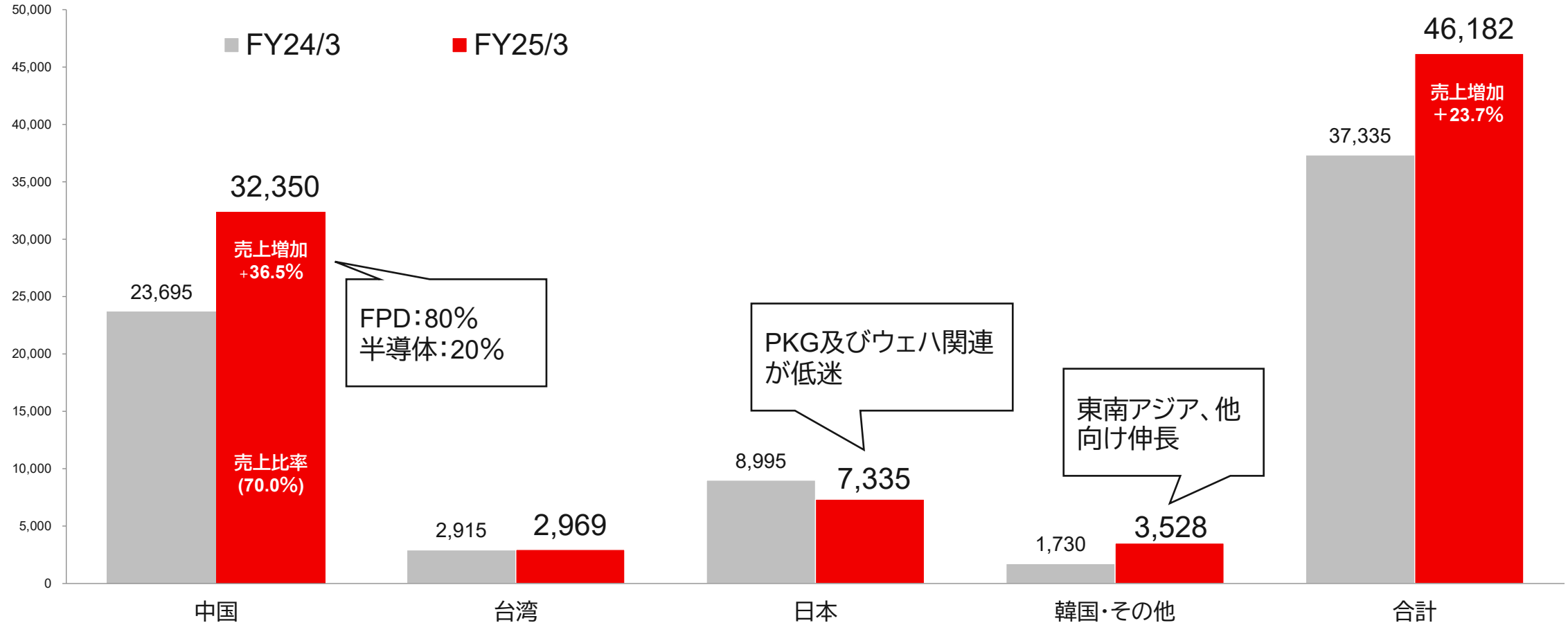
FPD装置事業(単位:百万円)			
	FY24/3	FY25/3	前年同期比
売上高	22,258	29,809	+33.9%
営業利益(▲損失) (セグメント利益率)	▲25 (-%)	912 (3.1%)	+937 (-)



3. 地域別売上高

FPD装置事業の中国向け販売が増加、一方で、日本国内の半導体関連販売が停滞

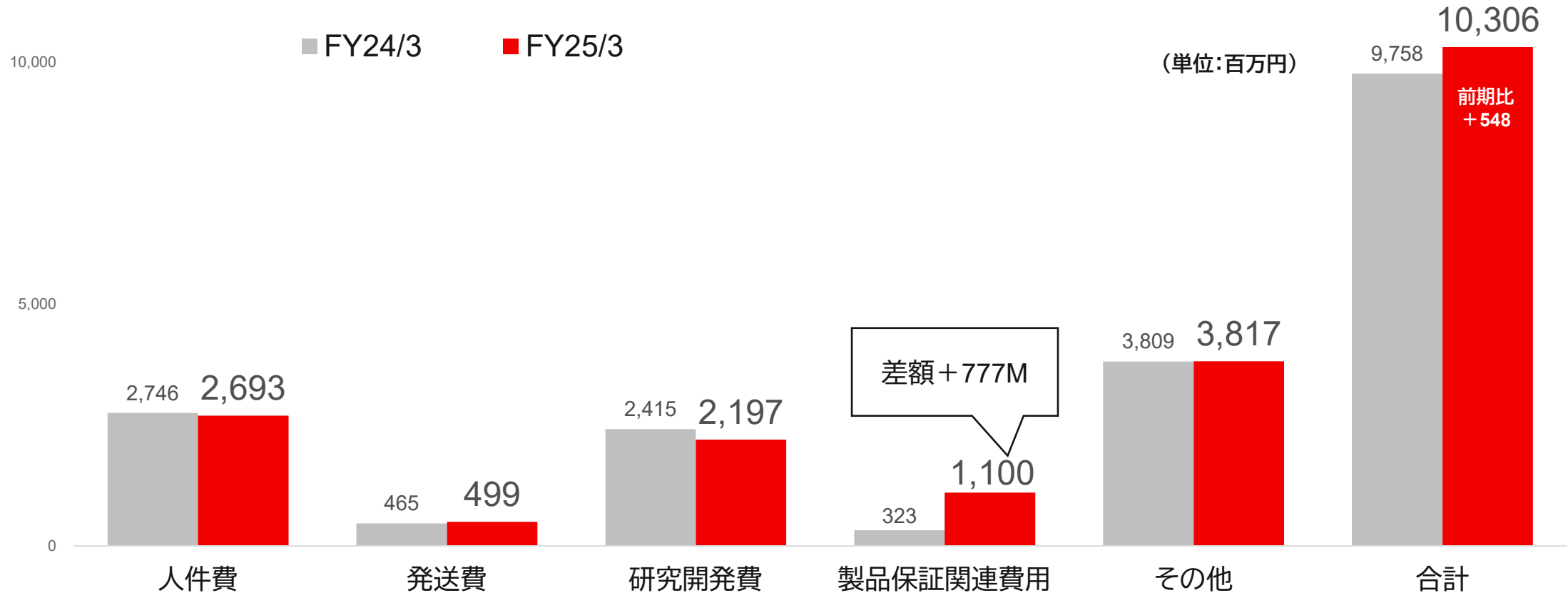
(単位:百万円)



4. 販売費及び一般管理費

製品保証関連費用 FY24/3とFY25/3との差額+777Mについて

- ✓ 要因1: FY24/3に、既存装置に関する過去からの引当金につき、装置対応習熟化に伴い、引当不要と判断して戻入を行ったこと。
- ✓ 要因2: FY25/3に、新製品への対応により、製品保証引当の増加に加えて、売上計上後のアフターサービス費も増加したこと。

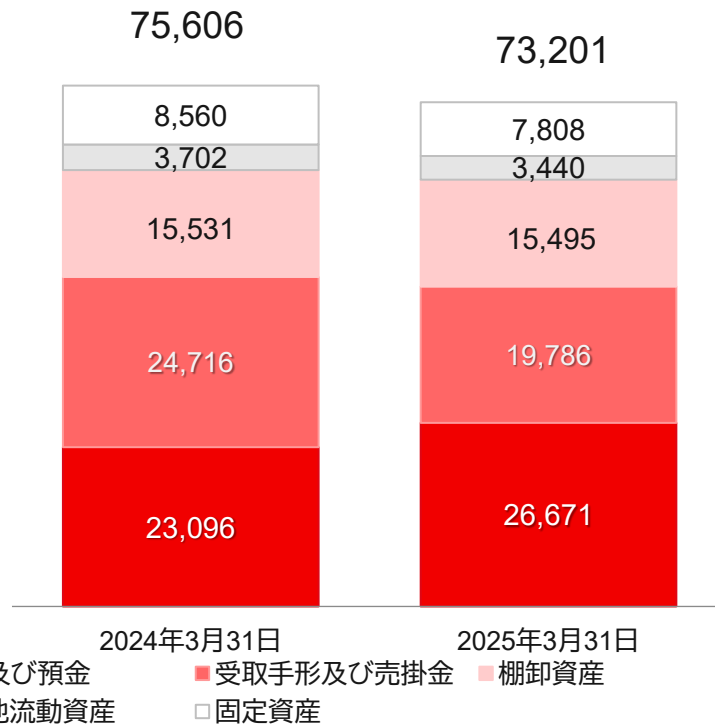


5. 貸借対照表

- 現金及び預金 : 受取手形及び売掛金の減少、借入金増加等から3,575百万円増加
- 受取手形及び売掛金: 主に海外顧客の支払い手続きが進展し、4,930百万円減少
- 固定資産 : 有形固定資産および投資その他の資産の減少等から、752百万円減少

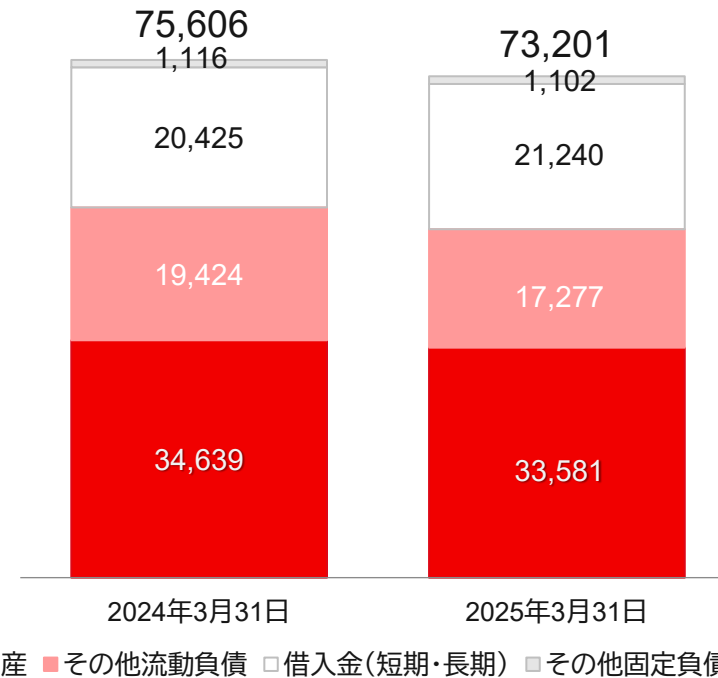
総資産

(単位:百万円)



負債・純資産

(単位:百万円)

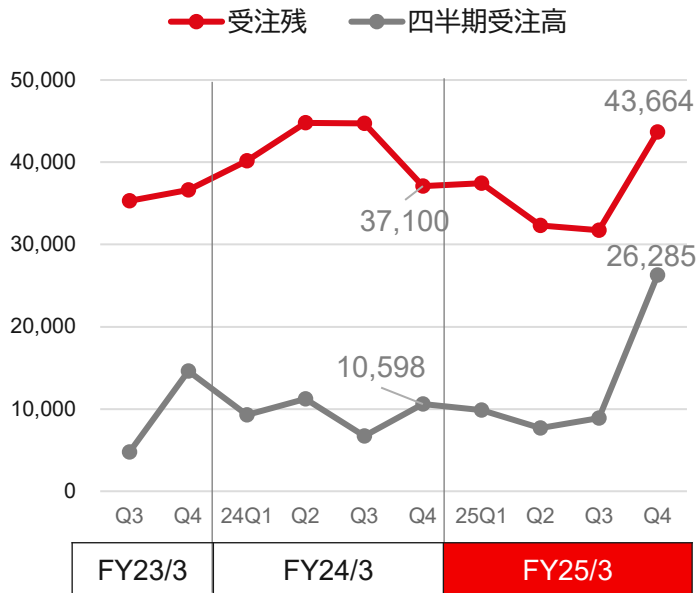


6. 受注・受注残の状況

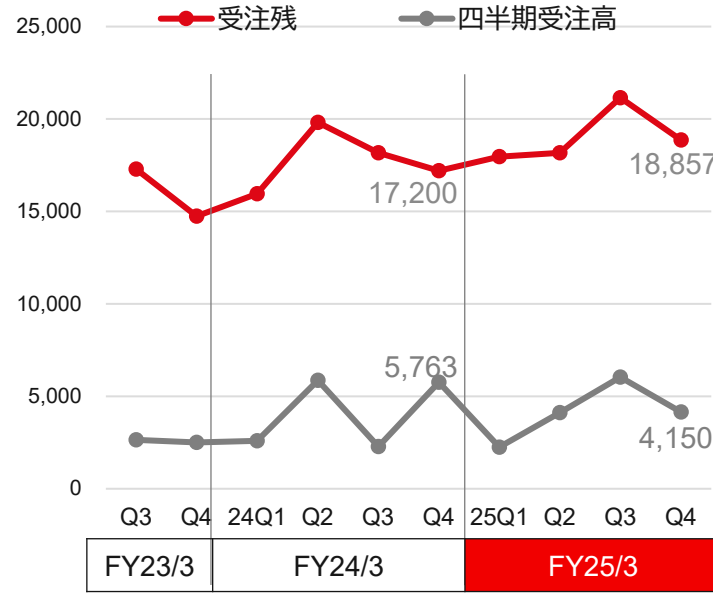
目標としていたFY25/3末の装置受注残額(410億円)を、約13億円上回る423*億円で通過

* メンテ含むトータルの受注残:436億円

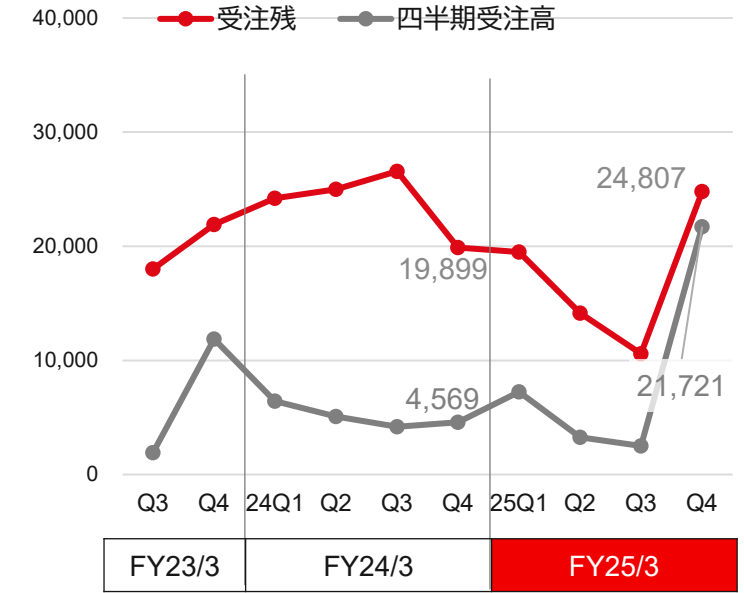
グループ全体		(単位:百万円)	
	FY24/3	FY25/3	前年同期比
受注残	37,100	43,664	+17.7%
受注高(累計)	37,788	52,747	+39.6%



半導体・フォトマスク装置事業		(単位:百万円)	
	FY24/3	FY25/3	前年同期比
受注残	17,200	18,857	+9.6%
受注高(累計)	16,510	16,562	+0.3%



FPD装置事業		(単位:百万円)	
	FY24/3	FY25/3	前年同期比
受注残	19,899	24,807	+24.7%
受注高(累計)	20,253	34,716	+71.4%



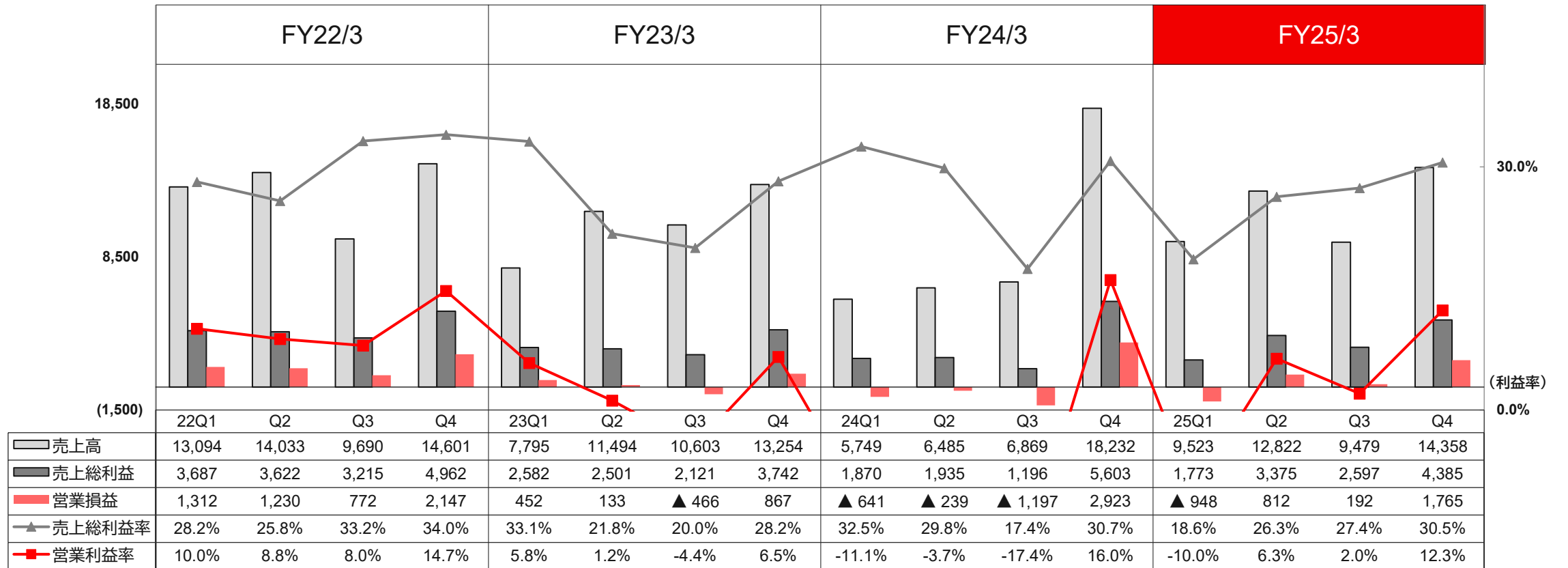
(ご参考) キャッシュフロー計算書

(単位:百万円)

		FY24/3	FY25/3
営業活動による キャッシュフロー	税金調整前純利益(▲損失)	1,181	1,383
	売上債権(▲増加)	▲2,278	4,829
	棚卸資産(▲増加)	▲5,397	89
	仕入債務(▲減少)	4,816	▲3,205
	前受金(▲減少)	▲3,746	536
	その他	660	1,712
	Total	▲4,764	5,344
投資活動によるキャッシュフロー Total		▲440	▲1,470
財務活動による キャッシュフロー	借入による収入	10,618	15,035
	返済による支出	▲8,490	▲14,278
	その他	▲602	▲1,228
	Total	1,526	▲471
現金及び現金同等物に関わる換算差額		276	▲170
現金及び現金同等物の増減額(▲減少)		▲3,402	3,231
現金及び現金同等物の期首残高		26,295	22,893
現金及び現金同等物の期末残高		22,893	26,124

(ご参考) 四半期売上・利益の推移

(単位:百万円)



| II. 2026年3月期 業績予想

(百万円)		FY25/3実績	FY26/3 業績・配当の予想	
		数値	数値	前期比
売上高		46,182	56,000	+23.4%
営業利益		1,822	4,500	+147.0%
(利益率)		3.9%	8.0%	
経常利益		1,891	4,200	+122.1%
(利益率)		4.1%	7.5%	
親会社株主に帰属する当期純利益		800	2,700	+232.2%
(利益率)		1.7%	4.8%	
EPS(円)		84.07	285.71	+201.64
配当(円)	中間	40	40	—
	期末	40	40	—
(ご参考) 配当性向		95.2%	28.0%	▲67.2%

III. 中期経営計画 FY25/3～FY29/3

FY25/3の振り返りと、今後について

1. 中期経営計画

- (1) 概要
- (2) 米中対立の影響
- (3) 内部組織の見直し
- (4) 事業分野ごとの製品開発とフェーズ
- (5) 数値目標

2. 半導体・フォトマスク装置事業

- (1) アドバンストパッケージ
- (2) フォトマスク
- (3) 半導体(ウェハ・ラボ・その他)

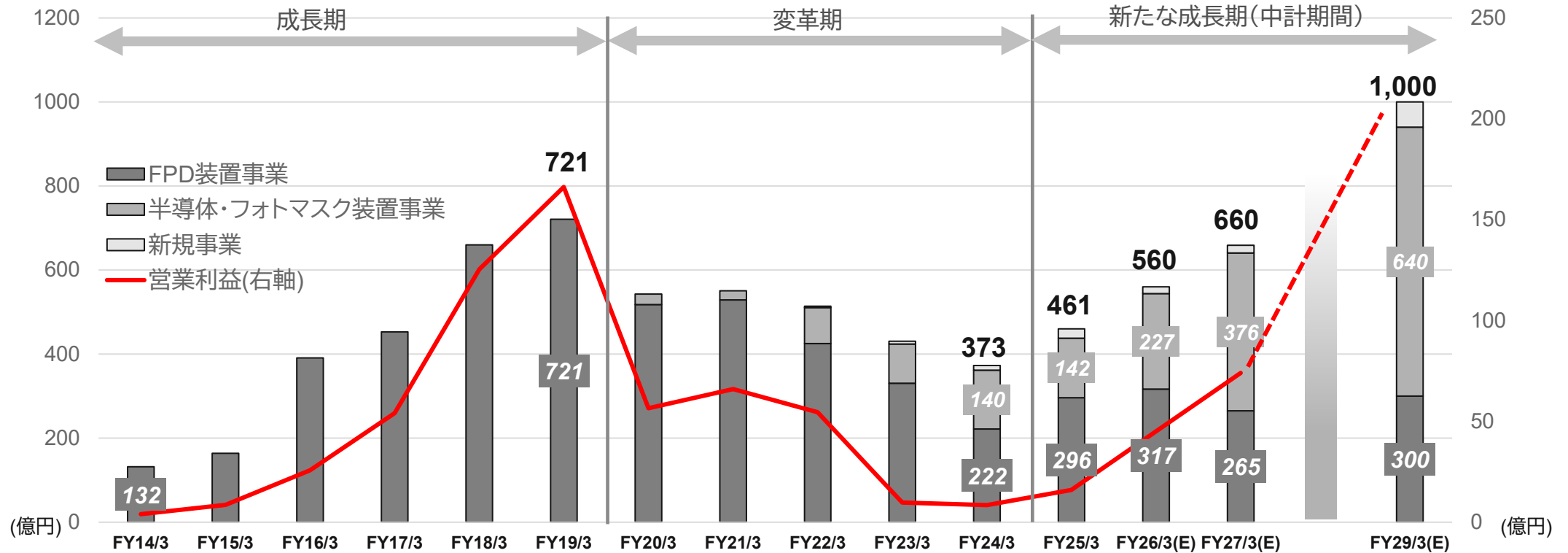
3. フラットパネルディスプレイ装置事業

| 1. 中期経営計画

- (1) 概要
- (2) 米中対立の影響
- (3) 内部組織の見直し
- (4) 事業分野ごとの製品開発とフェーズ
- (5) 数値目標

1. 中期経営計画 (1)概要

- 中計1年目のFY25/3期は、概ね目標値に沿った着地
- FY26/3期以降の飛躍に向け、引き続き様々な施策を推進



連結売上高(左軸)・営業利益(折れ線・右軸)の推移

1. 中期経営計画 (2)米中対立の影響

- 対中輸出規制や関税率等の動向への懸念が高まる状況
- 「中国」と「以外の地域」で考え方を完全に分けて事業を推進していく

中国

短期：影響は殆ど無し

- 現時点で注文キャンセル、納入計画の変更等、直接的な影響無し
- 当社半導体関連装置の売上高中国比率:44%(先端用途販売無し)
- FPD製造装置は規制対象外
- 米国産部品の装置使用は25%未満(エンティティリスト規制対象外)

中長期:「中国市場は中国市場で」

- **米国市場への参入を視野に**
- 現地化を推進し、事業を更に発展
 - JV社設立と連結決算取込
 - 製造に加え、開発、調達現地化の検討
 - リスク管理体制強化(知財保護、契約)、他

2025年は
FPD装置
現地生産

以外の地域

重要性が増すインド・東南アジア

- インドにおける、LCD等の新工場投資検討
- 2024年にベトナムにアフターサービス拠点を設立

日本・韓国・台湾

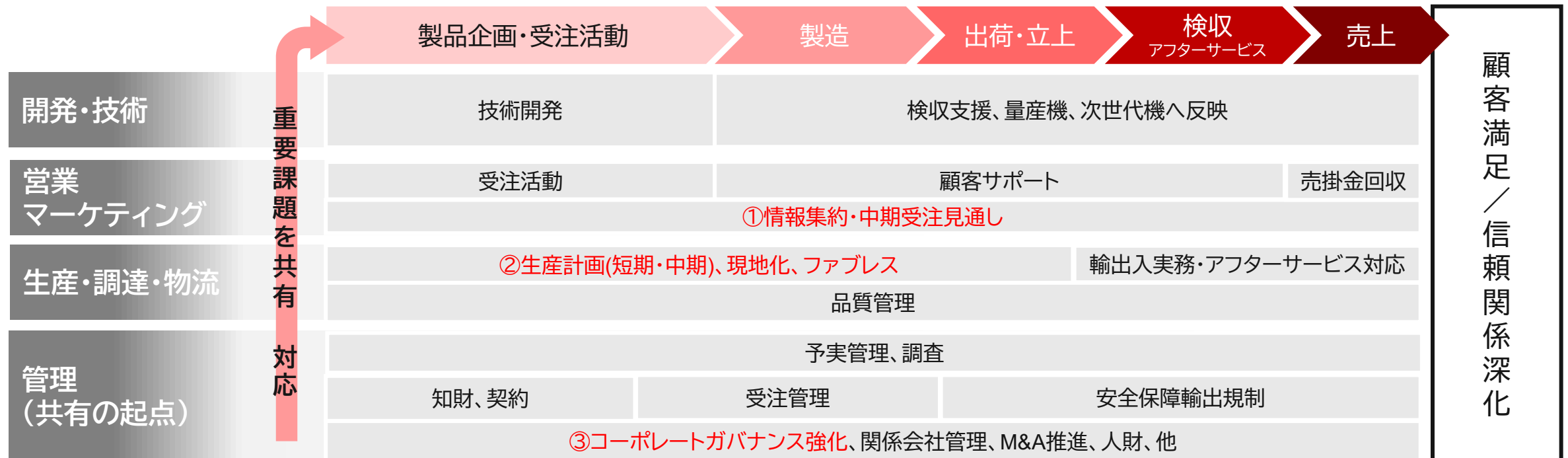
- 既存拠点の有効活用
- 顧客と共同開発
 - 日本:後工程技術
 - 台湾:先端半導体技術
 - 韓国:メモリ技術

米国

- 拠点新設を検討
- 各社へ後工程向け提案

1. 中期経営計画 (3)内部組織の見直し

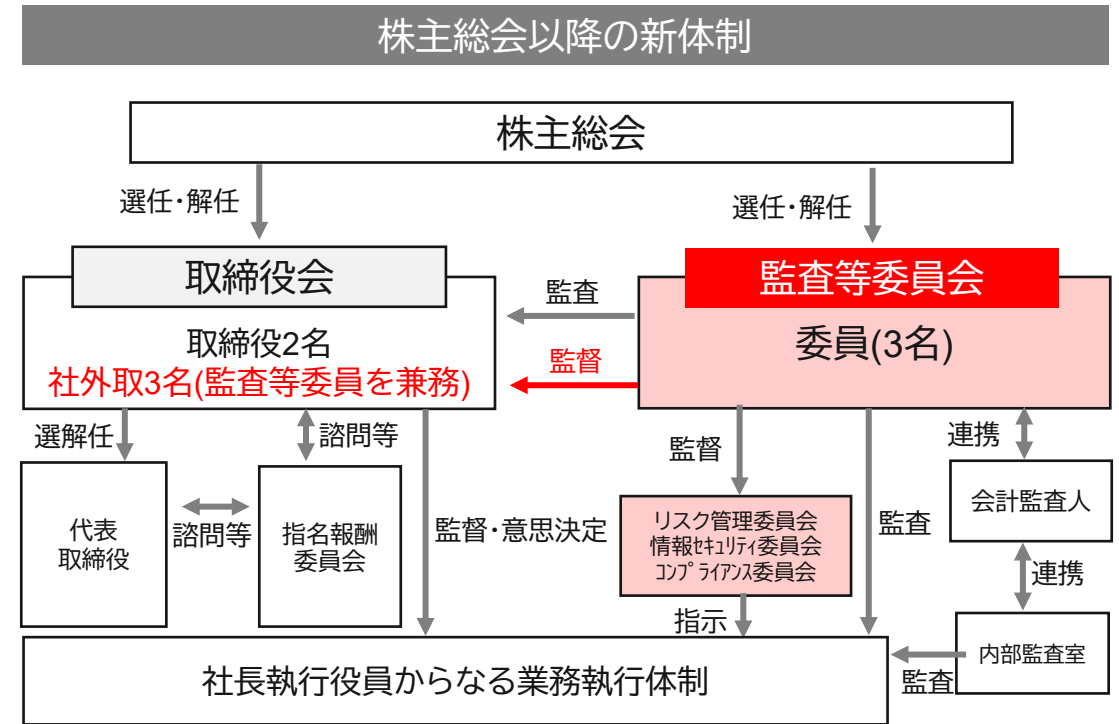
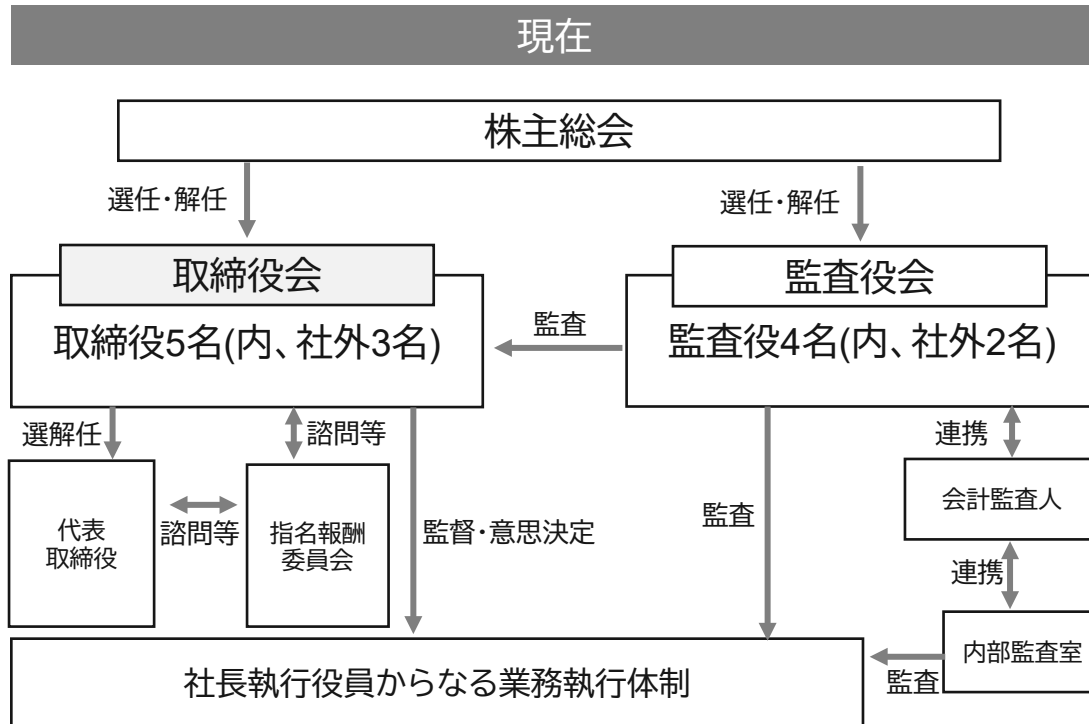
- ① 営業・マーケティング :情報集約・グループ内共有(ビジネスチャンスを逃さない)、中期受注見通し
- ② 生産・調達・物流 :中期受注計画に基づく生産体制の整備、部材・委託先のリスト化
- ③ 管理 :コーポレートガバナンス強化(次項)



(参考)監査等委員会設置会社へ移行

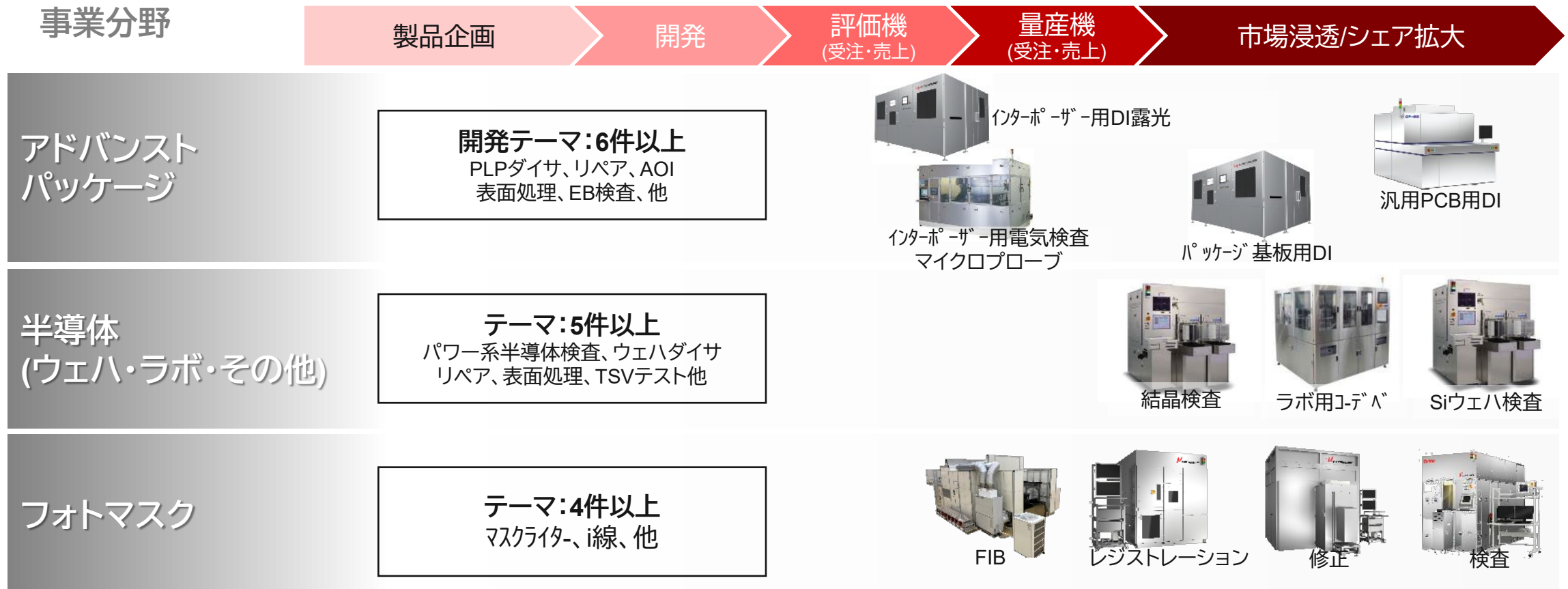
監査等委員会設置会社へ移行、ガバナンスを強化

- ✓ 取締役2名と社外取締役3名(監査等委員を兼務)によるコンパクトな機関設計とすると同時に、独立性を確保
- ✓ リスク管理、情報セキュリティ、コンプライアンス委員会の新設
- ✓ 半導体分野に詳しい新メンバーが加入
- ✓ 新しい知見・視点を経営判断に導入するべく、女性取締役を2名(弁護士、会計士)体制に変更



1. 中期経営計画 (4)事業分野ごとの製品開発とフェーズ

- 技術トレンドに先駆ける製品開発を展開中
- 顧客・協力会社・大学等研究機関と協業、実用化を急ぐ



1. 中期経営計画 (5)数値目標

高付加価値製品を主とした製品群による、一定規模の売上高を実現し、ROE/PBR(株価)の大幅な改善を目指す

- ・ 中計1年目(FY25/3):概ね計画通りの着地 (FY25/3の決算ご参照)
- ・ 同2年目 :FPD投資は堅調、半導体関連は想定より需要が弱く、セグメント別売上高を修正
- ・ 同3年目 :FPD投資は一服、半導体はインターポザ量産、新製品の収益寄与を前提にセグメント別売上高を修正
- ・ 同4年目以降 :主力製品・新製品の市場浸透、AI用半導体の普及、最終製品需要の成長を前提に、目標を据置き

指標(下線太字)	2024年3月期 (実績)	中期経営計画 数値目標 2025年5月14日時点							
		2025年3月期		2026年3月期		2027年3月期		2029年3月期	
		前回目標値	実績	前回	新	前回	新	前回	新
売上高(億円)	373	470	461	570	560	670	660	1,000	1,000
内、半導体・フォトマスク装置事業	140	225	149	316	227	358	376	680	640
内、FPD装置事業	223	230	298	230	317	280	265	250	300
内、新規事業	10	15	14	24	16	32	19	70	60
営業利益(億円)	8.5	16.0	18.2	45.0	45.0	74.0	74.0	200.0	200.0
営業利益率	2.3	3.4	3.9	7.9	8.0	11.0	11.1	20.0	20.0
*ROE (%)	2.3	2.9	2.4	8.2	8.2	12.5	12.5	23.7	23.7

*ROEは、為替影響を織り込んでおりません。

2. 半導体・フォトマスク装置事業

成長分野での事業展開とパッケージ戦略

- (1) 当社製品が関連する市場
- (2) アドバンストパッケージ・PCB
- (3) フォトマスク
- (4) 半導体(ウェハ・ラボ・その他)

(1) 当社製品が関連する市場について

複数の市場で収益基盤を立上げ、事業の安定成長を追求

✓ 装置需要は、関連市場の数%~10%台後半での規模感で、かつサイクリカルな推移を想定

当社関連市場の規模と成長率*

	CY24	年平均成長率 (予測)	CY29(予測)
	規模(10億USD)		規模(10億USD)
半導体	611.2	10.3%	1,034.0
先端PKG基板	11.9	16.9%	26.2
汎用PCB	52.9	4.0%	66.9
フォトマスク	7.7	5.6%	10.1
Siウエハ	11.5	8.5%	16.1
半導体材料	57.5	10.6%	95.0
フラットパネルディスプレイ	132.3	2.6%	150.3

*調査会社資料(OMDIA社、Yole社、他)、団体資料(SEMI、WSTS、WECC)、他、会社資料より当社にて作成

(2) アドバンストパッケージ① パッケージ戦略

製造工程の課題をトータルで解決する「パッケージ戦略」を展開

- (下図灰枠).....既存領域、新製品の市場浸透の加速、顧客との関係強化等から市場を深耕
- (同緑枠).....社外パートナーとの新製品開発.....TSV検査、Siウェハ・PLPダイシング・穴加工・他の技術開発
- (同赤枠).....既存技術を応用した製品展開

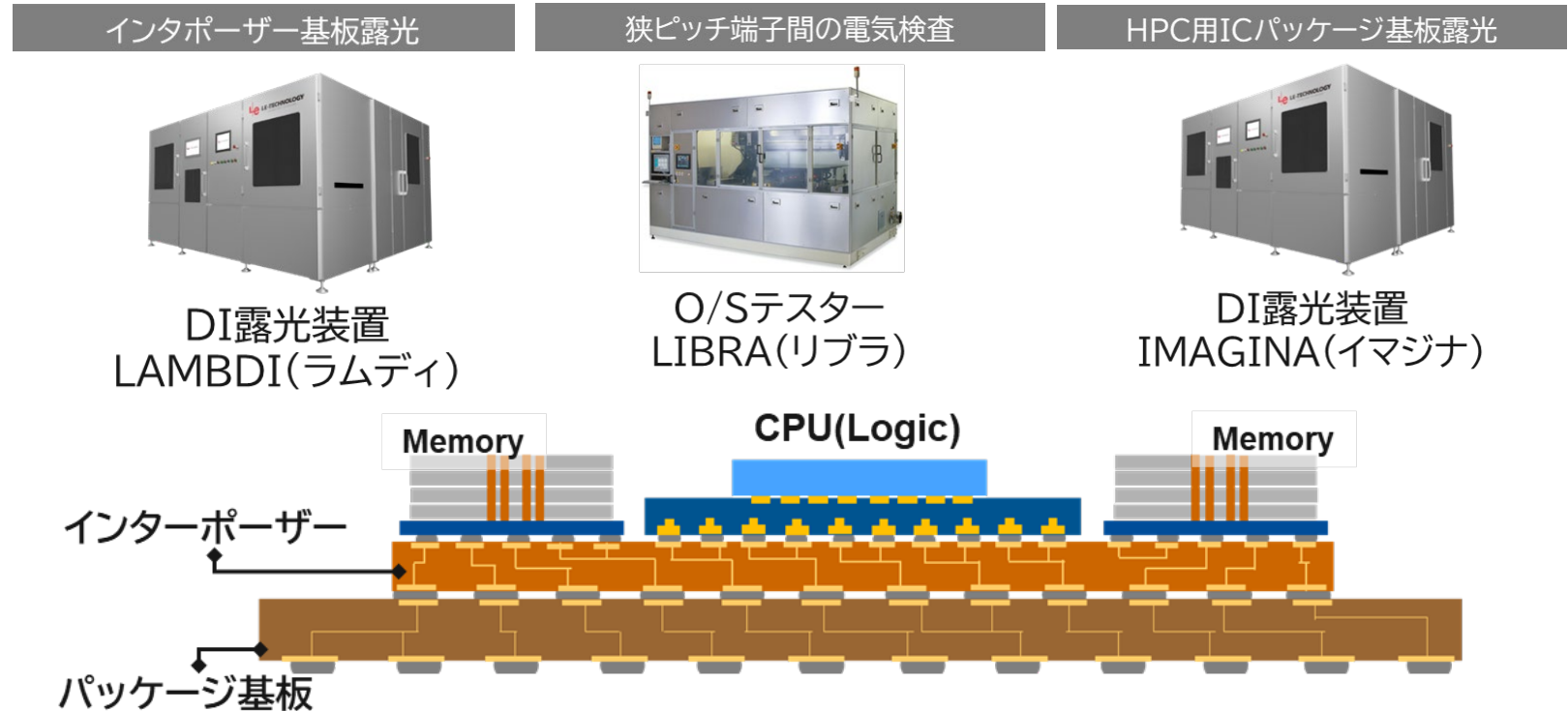
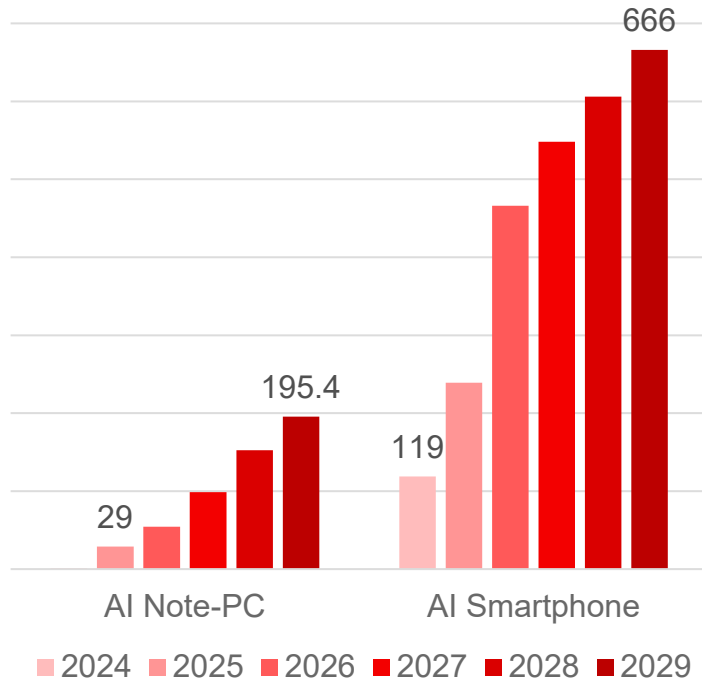
*実績ある工程に社名略称を記載 **N/A(対象外)		アドバンストパッケージ・PCB		半導体製造(後工程)	左記共通部材
		汎用PCB	アドバンストパッケージ インターポージャー	インターポージャー/他	フォトマスク
製造工程 (上流~下流)	露光(直描)	*VT(協業)	LET	LET	NSS/VT
	電気検査	OHT	OHT/VT(μプローブ)	次の狙い(HBM)	N/A**
	検査関連(AOI等)	N/A	開発中		VT
	ダイシング(個片化)	N/A	開発中		N/A
	洗浄/デハ/エッチング	JAC	JAC	開発中	JAC

略称 VT:ブイ・テクノロジー/LET:LE-TECHNOLOGY/NSS:ナノシステムソリューション/OHT:オー・エイチ・ティー/JAC:ジャパングリエイト

(2) アドバンストパッケージ② 事業環境と主要製品

- AIサーバー需要に加え、AI機能を実装する高性能な端末(モバイル、オフィス、その他)の普及を想定
 - ✓ 成長を支える高性能かつ低コストなアドバンストパッケージ/インターポージャー技術への需要拡大を期待
- 顧客のCOO(Cost of Ownership)に寄与する製品ラインナップを整備

アプリケーションや技術進化に伴い
AI機能搭載端末の市場は拡大*
(million units)



*OMDIA社資料より、当社にて作成

(2) アドバンストパッケージ ③ 製品の状況等

- RDL関連でLAMBDA4号機の受注に成功
- 海外市場の開拓加速、O/Sテスター拡販、μプローブ量産、ガラス加工(ガラスダイシング)、AOI開発、他

露光+検査、フルラインナップの販売戦略を推進	
技術	強み・独自性
DI露光	インターポータ~汎用PCBまでフルラインナップ
インターポータ用O/Sテスタ	<ul style="list-style-type: none"> • 微細パターンに世界初対応 • グループ内技術によるμプローブの安定生産

インターポータ関連装置の市場浸透が進む	
当社製品	進捗など
インターポータ用DI	4号機を受注、半導体メーカー浸透加速
アドバンストパッケージ用DI	フリップチップ需要低迷/海外展開
インターポータ用O/Sテスタ	プローブカード量産、半導体メーカー展開

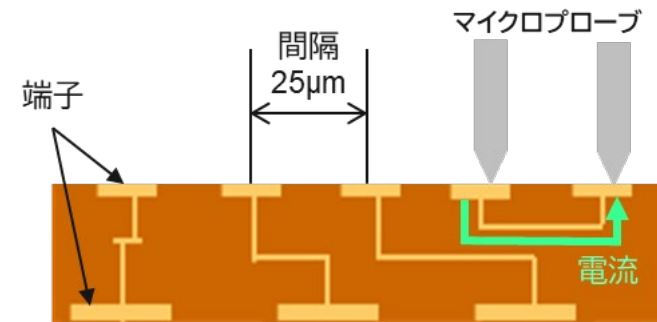
チップレット技術のトレンドを見据えた技術開発	
開発テーマ	進捗など
ガラスコア基板	顧客、グループ内企業等と共同開発中
高精細AOI・リペア・他	同上

インターポータ上の端子部の導通検査

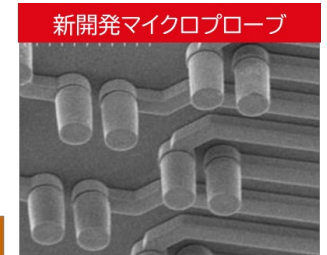
(課題)微細化により電気検査不可能



LIBRA+マイクロプローブで解決(世界初)



(図)LIBRAによる電気検査



アドバンストパッケージ
(赤枠部インターポータ)

(3) フォトマスク

- 旧式装置の置換や既存ライン増強に関わる需要の獲得
- 新製品の開発による製品ラインナップの拡大と、製品の差別化を推進し、事業を拡大していく

昨年リリース装置の市場浸透が進む中、新製品を投入を継続

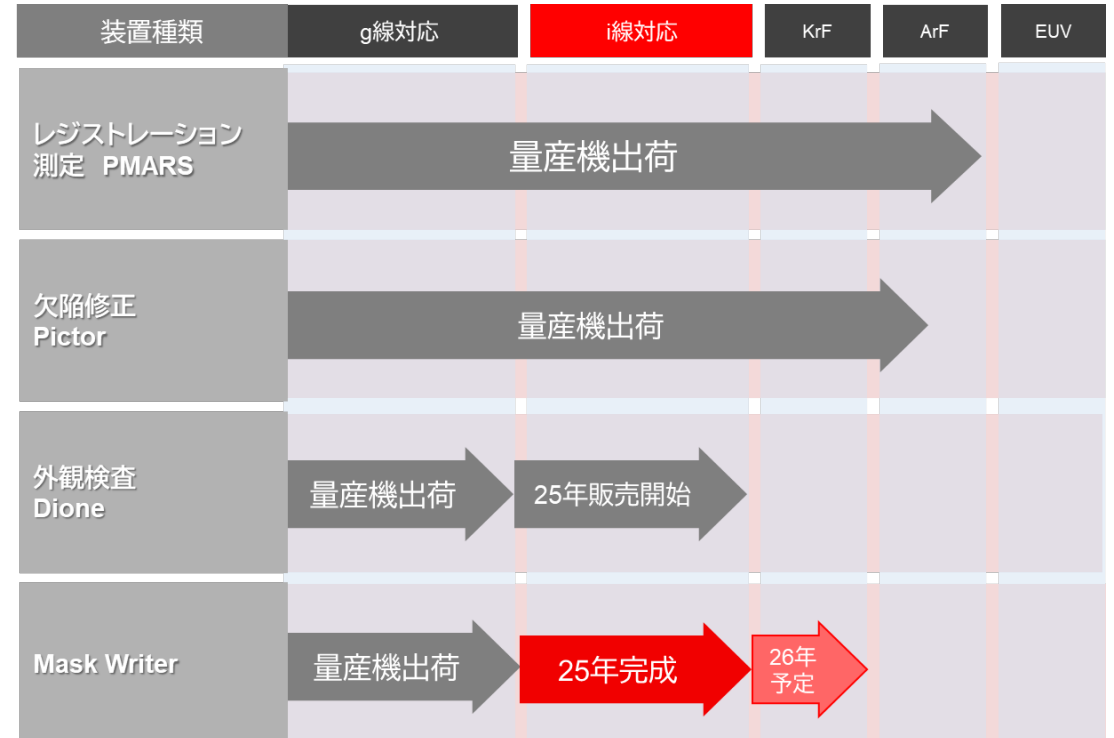
製品	強み/進展
全般	<ul style="list-style-type: none"> レガシー半導体およびFPDに展開 省スペース設計(既存装置とコンパチ) 高精度、高コスト競争力
レジストレーション	半導体メーカーへの浸透
外観検査装置	<ul style="list-style-type: none"> 既存顧客、マスク内製ライン需要の開拓 i線機の販売本格化
修正装置(FIB、他)	<ul style="list-style-type: none"> 大型マスク用の高精度修正として拡販 半導体用途の引合増
マスクライター	FPDマスク用として25年から販売開始

既存ラインの増強と置換に関連する需要について

- 生産能力の拡大に伴う需要増
 - レガシー半導体の半導体製造能力は、2027年までに約1.2倍~1.5倍(2024年比)となる見込み*
- 置換需要
 - レガシー半導体用マスク製造装置の多くが、稼働から20年以上経過、サポートを受けられない装置が毎年一定数発生

開発ロードマップ

i線対応、高速化を進める他に、FIB、マスクライターの開発を急ぐ



*OMDIA社資料より、当社にて作成

(4)半導体(ウェハ・ラボ・その他)

- 材料/デバイスの試作から量産まで、さまざま場面でプロセス課題の解決に寄与する製品を、国内外に幅広く展開
- レーザーダイサー等、2026年の新製品の投入を目指し技術開発推進中

シリコンウェハ...新製品が寄与しビジネスが進展

製品	強み/進展
検査装置	<ul style="list-style-type: none"> 高精度・高速、トップシェア 高品質ウェハ対応 SiC・GaN対応 海外市場の開拓進展

ラボ用装置...海外販売好調

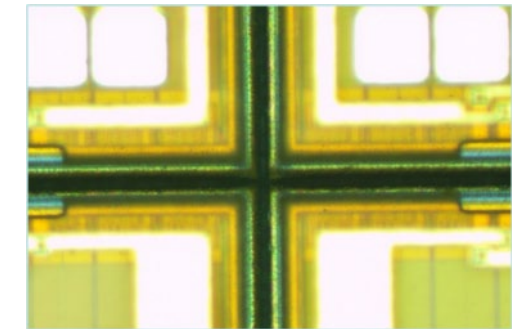
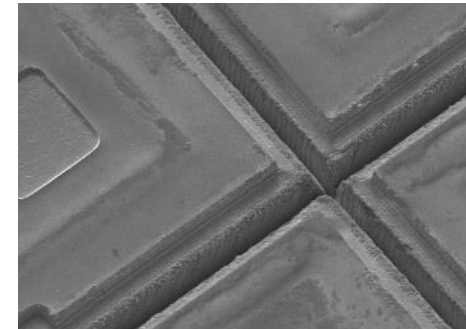
製品	強み/進展
コーダーデベロッパ/レジスタアナライザ/関連ツール	<ul style="list-style-type: none"> フォトリソ解析の経験・ノウハウ蓄積 各国の官民の研究機関向け好調

ウェット・ドライ装置...カスタム品の販売増を見込む

製品	強み/進展
<ul style="list-style-type: none"> Wetプロセス全般(コーター/デベロッパ/エッチャ/洗浄) 真空成膜装置(容器内、他) 	<ul style="list-style-type: none"> ニッチ需要へのカスタム品対応 電子デバイス分野での広範な販売実績 真空成膜応用(電子デバイス~食品、他)

レーザーダイサー「Vダイサー」

- チッピングや熱影響を最小化する加工技術を開発
- 薄く脆いウェハを精密に加工
 - ✓HBMのTSV配線長を短縮する為、ウェハを極限まで薄化
 - ✓薄く脆いウェハを、高品質にダイシングする技術への需要増



幅15μm/深さ40μm/V溝加工

| 3. フラットパネルディスプレイ装置事業

- 電子ペーパー新工場、既存工場の増強などから設備需要が回復
- セグメントの収益性改善に向け、有機EL材料およびサービス関連会社の一部を統廃合予定

昨年想定より設備需要は高水準で推移すると見込む

大型LCD 製造装置	<ul style="list-style-type: none"> • 露光装置、検査装置に高シェア製品豊富 • G10.5向け装置を4月に受注 • 検査関連装置の現地生産 • 顧客は既存工場の能力改善への意欲高い
蒸着マスク	<ul style="list-style-type: none"> • 高精細/高位置精度 • 蒸着マスクを正式受注
有機EL材料、他	関係会社の統廃合を予定

“超”大型サイズのテレビ販売が好調

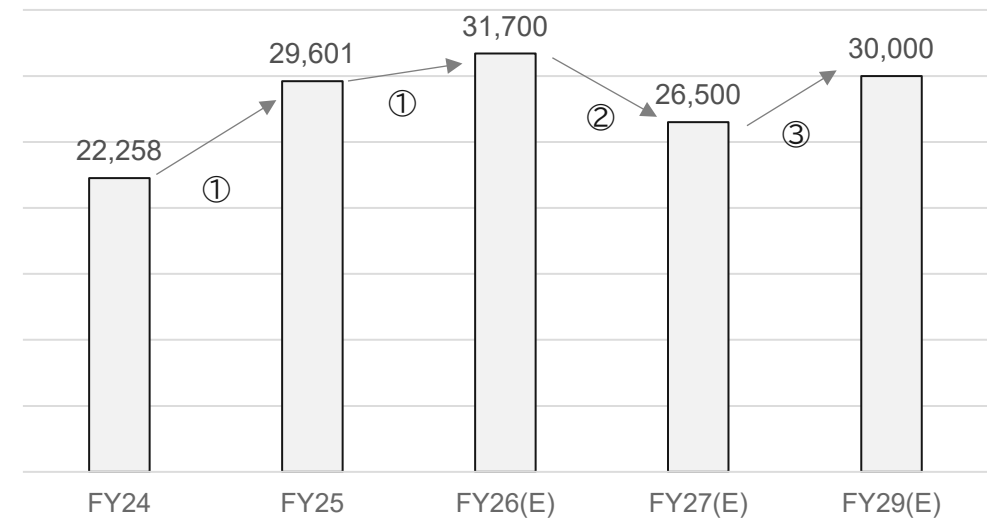
PHILE WEB(2025/2/20)より引用・

「ヨドバシAkibaのテレビ売り場に
“超”大型サイズがズラリ。
115V型を筆頭に70V型以上が47台」

<https://www.phileweb.com/news/d-av/202502/20/62139.html>



今後の販売見通し(単位:百万円)



ポイント

- ① 電子ペーパー新工場、既存工場増強
- ② 設備需要一服
- ③ インド等新興国(FY28/3~)投資規模・時期により変動

| IV. その他

～地域・社会貢献の取組例～

大人柔道家への技術講習会 (志道館 文武一道塾 様 主催)



2024年11月に当社綱島柔道場にて「柔フェス大人柔道部 大人柔道家のための技術講習会」が開催され、宇高監督及び部員がコーチを務めました。

<https://www.bunbuichido.net/20241123-udakanae-oosotogari-technical-seminars-report/>

嘉重選手が柔道日本代表に選出



2024年の講道館杯、及び柔道グランドラムの2大会での優勝実績より、嘉重選手が女子63kg級の日本代表選手に選出、今年6月開催のブタペスト世界柔道選手権に出場いたします。

台湾地震への寄付

台湾は、お客様を始め、協力会社の方々、現地法人の役職員等と数多くのビジネスを創業初期から展開しており、当社にとって非常に重要な地域です。

2024年4月3日に発生した台湾東部沖地震による災害に対する支援について、地震で被災された皆様への支援及び、大きな損害を被った地域の迅速な復旧と復興への貢献を目的として、日本赤十字社を通じ1,000万円の義援金の寄附をいたしました。

また、本寄附について2024年12月21日に、紺綬褒状の授与が決定されました。

・ 将来見通し

本資料に記載されている当社の計画、戦略、見通し及びその他の歴史的事実でないものは、将来に関する見通しであり、これらは現在入手可能な期待、見積、予想に基づいています。これらの期待、見積、予想は、経済情勢・市況の変化、競争環境の変化、顧客のある国の政策変化、係争中及び将来の訴訟の結果など多くの潜在的リスク、不確実な要素、過程の影響を受けますので、実際の業績は見通しから大きく異なる結果となる可能性があります。従って、これら将来予想に関する記述に全面的に依拠することは差し控えて頂きますようお願いいたします。また、当社は新しい情報、将来の出来事などに基づきこれらの将来予測を更新する義務を負うものではありません。

・ 数字の処理

記載された金額は、単位未満を切り捨て処理、比率は単位金額で処理した結果を四捨五入している為、内訳と一致しない場合があります。

・ 事業セグメントの構成

・ 半導体・フォトマスク装置事業

半導体製造工程における製造装置、検査装置及びフォトマスク用装置等の開発・設計・製造・販売・関連サービス、及びPCB用装置で構成されています。

・ FPD装置事業

FPD製造工程における製造装置、検査装置等の開発、設計、製造、販売、関連サービス及びOLED用蒸着マスクをはじめとする部材等で構成されています。

お問合せ先
社長室 IRグループ
vtj-mng-pre@vtec.co.jp

